

杭州士兰微电子股份有限公司

关于控股子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目（即“8 吋芯片生产线二期项目”）的议案》，同意公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）对 8 吋芯片生产线进行技术改造，形成新增年产 43.2 万片 8 英寸芯片制造能力。“8 吋芯片生产线二期项目”总投资 15 亿元，其中股东出资约 8 亿元，其余资金通过向金融机构融资解决。士兰集昕将新增注册资本 702,983,849 元，公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）以货币方式共同出资 8 亿元认购士兰集昕新增的全部注册资本。

公司于 2019 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议以及 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，同意公司使用募集资金 3 亿元及自有资金 0.15 亿元、大基金出资 3 亿元共同向杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）增资，并通过集华投资和大基金向新增募投项目之“8 吋芯片生产线二期项目”的实施主体杭州士兰集昕微电子有限公司共同增资 8 亿元（其中 3 亿元为募集资金）的事项。

上述事项以及集华投资、士兰集昕和大基金等公司的基本情况详见公司于 2019 年 8 月 28 日和 2019 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《关于投资建设士兰集昕二期项目的公告》（公告编号：临 2019-037）和《关于调整募集资金投资项目相关事项的公告》（公告编号：临 2019-046）。

二、投资进展情况

公司于 2019 年 11 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关

于控股子公司增加注册资本的议案》，同时董事会授权董事长陈向东先生及公司管理层办理增资、认缴及工商变更等相关事宜，具体增资情况如下：

1、集华投资增加注册资本事项

集华投资本次将新增注册资本 6.15 亿元，其中：本公司以货币方式认缴出资 3.15 亿元人民币（其中 3 亿元为募集资金，0.15 亿元为自有资金），大基金以货币方式认缴出资 3 亿元人民币。增资完成后，集华投资的注册资本将从 4.1 亿元增加至 10.25 亿元。本次增资无溢价。

认缴集华投资新增注册资本的出资分两期进行：第一期本公司出资 2.1 亿元（其中 2 亿元为募集资金，0.1 亿元为自有资金），大基金出资 2 亿元；第二期本公司出资 1.05 亿元（其中 1 亿元为募集资金，0.05 亿元为自有资金），大基金出资 1 亿元。

增资完成前后，集华投资的股权结构如下所示：

股东名称	增资完成前的持股比例	增资完成前的出资额（万元）	增资完成后的持股比例	增资完成后的出资额（万元）
杭州士兰微电子股份有限公司	51.22%	21,000	51.22%	52,500
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	48.78%	20,000	48.78%	50,000
合计	100.00%	41,000	100.00%	102,500

2、士兰集昕增加注册资本事项

士兰集昕本次将新增注册资本 702,983,849 元。本次增资每注册资本 1 元对应的增资款为 1.13800623 元，故增资款 8 亿元认缴注册资本 702,983,849 元。其中：增资后的集华投资以货币方式出资 6 亿元，认缴注册资本 527,237,887 元；大基金以货币方式出资 2 亿元，认缴注册资本 175,745,962 元。增资完成后，士兰集昕的注册资本将从 1,259,395,563 元增加至 1,962,379,412 元。本次出资溢价部分将计入士兰集昕的资本公积。

认缴士兰集昕新增注册资本的出资分两期进行：第一期集华投资出资 4 亿元（其中 2 亿元为募集资金）；第二期集华投资出资 2 亿元（其中 1 亿元为募集资金），大基金出资 2 亿元。

增资完成前后，士兰集昕的股权结构如下所示：

股东名称	增资完成前的持股比例	增资完成前的出资额（元）	增资完成后的持股比例	增资完成后的出资额（元）
杭州士兰微电子股份有限公司	9.80%	123,454,935	6.29%	123,454,935
杭州士兰集成电路有限公司	5.74%	72,303,290	3.68%	72,303,290

杭州高新科技创业服务有限公司	20.94%	263,637,338	13.44%	263,637,338
杭州集华投资有限公司	31.76%	400,000,000	47.25%	927,237,887
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31.76%	400,000,000	29.34%	575,745,962
合计	100.00%	1,259,395,563	100.00%	1,962,379,412

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于提高公司资产质量，降低项目投资成本，促进募投项目顺利实施，有利于加快公司8吋芯片生产线的建设和运营，进一步提升公司制造工艺水平，增强盈利能力，提高综合竞争力。

四、其他说明

有关该事项的后续进展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019年11月26日